

# Fuzion XC2-60



## 重新界定生产能力 应付高容量输入生产的完美方案

### Fuzion XC2-60平台

环球仪器的Fuzion™平台是现代贴片平台的一个革命性创举，能让各电子生产厂家在提升生产力至最高水平的同时，实现成本下降。Fuzion™系列平台配备的送料器站位，超过传统贴片机两倍以上，大大减少换线的需要及提高平台使用率。

在Fuzion系列平台中，Fuzion XC2-60™是一个高速平台，并进一步将传统平台的性能扩展，它能处理更大的电路板及在飞行中实现最大范围的元件贴装。Fuzion XC2-60是一个高性价比及性能极高的转塔式贴装平台替代方案，也是一个高容量输入的贴装平台。

### Fuzion XC2-60优势

- 重新界定生产能力 – 送料器站位为传统平台的两倍
- 充分利用生产设备及提高效率 – 令新品导入更流畅，减少换线
- 高度灵活的一体化设备 – 在不能确定产品特性的环境下，可以接受任何生产订单
- 最低的购置成本 – 可以减低资本投入及生产成本
- 充分发挥厂房面积使用率 – 一台具有更多送料器站位的Fuzion平台能取代多个模组

### 重新界定生产能力

- 比同类方案拥有双倍的8毫米及盘式送料器站位
- 一台具有更多送料器站位的Fuzion平台能取代多个模组
- 业界送料器站位密度最高，平均每个送料器站位的成本最低

Fuzion XC2-60



### 替换老旧的转塔式贴装机器

它能大大优化生产力，大幅度减少占地面积，能应对更大的电路板和范围更广的元件/封装；通过配备更多送料器站位、台车换料及可连续接料送料器，能将设备的使用率发挥至极限。



### 高速贴装平台

它的送料器站位数量为同类型方案的两倍，更可支持多个产品设置，减少换线时间，兼且能贴装的元件/封装范围极广，绝不降速贴装，可充分发挥设备的使用率。



### 高产量高复杂性组装方案

它能支持高复杂性及高元件数组装，同时可减少资本投资额、占地面积、新品导入时间及维护成本。



### 充分利用生产设备及提高效率

- 厂家的设备使用率一向偏低
- Fuzion方案送料器站位为其他平台的两倍，可以将平台使用率提升50%，大大提升产能 – 足以令电子生产厂家减少一个生产班次
- 在同一个平台上，可以设置多种产品的生产，去除换线工序
- 固定设置针对同一产品系列
- 可以采用“一料多站”或“替补供料”模式设置送料器站位
- 可以在平台上任意放置生产所需的送料器 – 非常灵活的送料站位设置
- 可以在新品导入模式或在飞行中进行参数调整，加快进入大量生产环境
- 灵活、容易上料、可连续接料的送料器，减少补充送料器及换线时间



### 高度灵活的一体化设备

- 在不能确定生产特性的环境下，可以接受任何产品的生产
- 在单一平台上进行试产，然后可以轻轻松松地转入大量生产
- 可以应对范围甚广的元件、封装类型及电路板尺寸
- 应对任何尺寸的电路板 -- 最大为1300毫米 X 610毫米 (51寸X 24寸)
- 应对任何元件–在飞行中实现最大范围的元件贴装，并能在贴装头上识别01005无源器件至30毫米平方的元件
- 线上备有372个吸嘴，能在高混合的生产环境中，去掉重新调整的需要

### 最低的购置成本

- 减少资本投资额及整体生产成本
- 较同类方案可采用更少模组
- 所需要的操作员数量、培训成本、维护成本、电力/压缩空气用量、编程及劳动/维修成本更低

### Fuzion XC2-60技术参数

贴片速度(cph(秒/元件))	最高	65,500 (0.055)
精度(微米@1.33 Cpk/1.00 Cpk)	1-Bd IPC晶片(1608)	30,000 (0.120)
电路板尺寸(毫米(英寸))	晶片，集成电路	±55/±41
	最大(宽x长)	610 x 1300 <sup>1</sup> (24 x 51)
	最小(宽x长x高)	50.8 x 50.8 x 0.508 (2 x 2 x 0.02)
元件范围(毫米(英寸))	最高重量(千克(磅))	5.0 (11.0)
	最大(宽x长x高)	30 x 30 x 6 <sup>2</sup> (1.18 x 1.18 x 0.24)
机器尺寸(毫米(英寸))	最小(宽x长x高)	0.18 x 0.38 x 0.10 (0.007 x 0.015 x 0.004)
送料器站位	(长x深x高)	2385 x 2160 x 1930 (93.90 x 85.04 x 75.90)
		多达264个8毫米站位-类型：带式、条状带式、盘式

<sup>1</sup>须使用长板工具选项

<sup>2</sup>请翻阅机器规格说明书查询贴装元件规格



### 定位系统

Fuzion XC2-60平台建立在环球仪器所有贴片机平台的成功基础上，采用专利的VRM线性马达技术，精度高达1微米分辨率，加速度高达2.5G，采用双驱动架构减少稳定时间。Fuzion平台的VRM线性马达技术，备有5年保用期。



### 贴装头技术

Fuzion XC2-60备有两个高速的FZ30™贴装头，速度为业内最快，能贴装由01005无源器件至30毫米平方的元件，其灵活性及表现无人所及。



### 视觉系统

FZ30贴装头备有两个放置在头上视觉系统，可以在飞行中拍摄整个系列元件，由01005无源器件至30平方毫米的元件。

- 窄小视野范围的相机识别01005至12毫米平方的元件
- 可以调整至较宽阔的视野范围以拍摄最大达30毫米平方的元件
- 可以拍摄无引脚、有引脚、球状及异型元件
- 镜头上备有垂直元件感应器，以确保元件到位/方位正确

### 垂直元件感应器

- 可在贴装前从侧面拍摄元件
- 可侦测从01005至30平方毫米元件到位
- 可量度元件高度，或对最高至1.27毫米的01005至0603无源器件，作垂直侧立检测
- 可检测吸嘴及可在飞行中更换问题吸嘴



### 细小元件贴装能力

- 可自动调校以保证第一次拾取便成功
- 自动更新X、Y轴的拾取位置来调校送料器的拾取点
- 闪电贴装头只用单点拾取，免除群组拾取的问题
- 接触位置传感器决定拾取及贴装高度
- Z轴自动调整来弥补拾取高度的差异
- Z轴自动调整来保证最佳的贴装力

### 通用的周边设施

- 所有Advantis 3、Genesis系列II、甚至更早的平台的周边设施，全部均适用于Fuzion XC2-60平台。